

TORAY IR Day

中期経営課題“IGNITION 2028”事業説明会

電子情報材料事業

2026年6月9日

東レ株式会社
上席執行役員 電子情報材料事業本部長

平野 昌宏



INDEX

目次

I 事業概要・東レの強み P.3-6

II AP-G 2025 振り返り P.7-8

III 事業環境・需要動向 P.9-10

IV 中期経営課題 “IGNITION 2028” P.11-26

V 2028年度の目標値と個別事業・施策の寄与度 P.27-28

I

事業概要・東レの強み

概要

主要分野

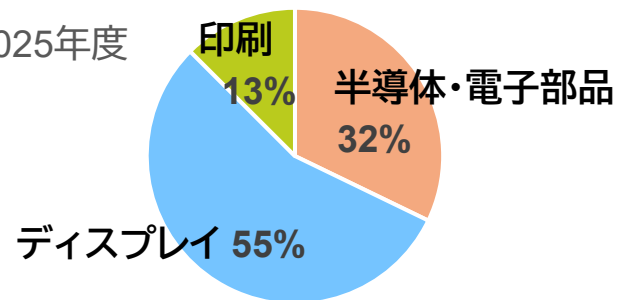
- 半導体・電子部品
- ディ스플레이
- 印刷

生産拠点

- 国内: 滋賀事業場、岡崎工場、愛知工場、東海工場
- 海外: チェコ、韓国

売上収益構成

2025年度



技術基盤

材料設計技術

高分子材料

感光性材料

微粒子分散材料

プロセス技術

重合・調合

塗工

フォトリソ加工

微粒子分散安定化

紡糸

東レが目指す世界の実現に向け、有力最終顧客との強固な協力関係を生かし、環境対応、次世代製品のタイムリーな上市による半導体・電子部品、ディスプレイ用途の高シェア維持、拡大を進める
 加えて、次世代半導体、光電融合など、成長領域における新事業創出を加速させる

TORAY VISION 2050

「2050年に向けて東レが目指す世界」

- ① 人と地球が調和し 資源が循環し、自然が再生していく世界

環境 | 脱炭素、リサイクル、空気

- ② 安全・安心な社会の中で 豊かさが生み出され
 分かち合える世界

社会 | 半導体、宇宙・防衛、モビリティ

- ③ すべての人が健やかに 心地よく暮らす世界

人 | 水、ヘルスケア、快適

成長性

② 次世代事業

(高成長・先行投資)

- 事業化に向けた研究開発投資
- 量産化に向けた設備投資

光電融合・次世代半導体

① コア成長事業

(高成長・高収益)

- 更なる成長に向けた設備投資、M&A

半導体・電子部品、ディスプレイ

③ 構造改革事業

(低成長・低収益)

- 収益性の早期改善
- 今後の成長余地の見定め／ベストオーナーか見定め

安定収益事業

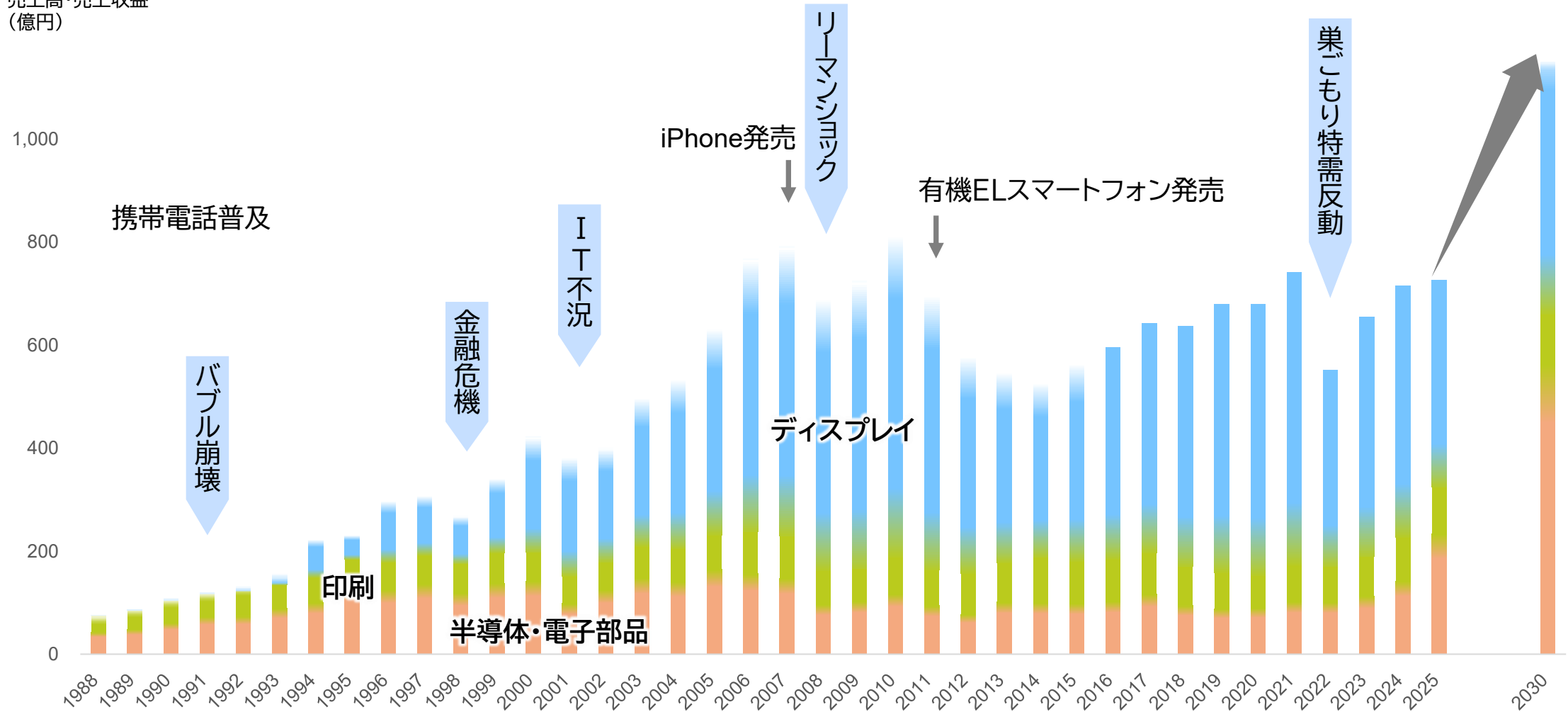
(低成長・高収益)

- 市場成長に合わせた設備投資及び、設備修繕

印刷

収益性

売上高・売上収益
(億円)

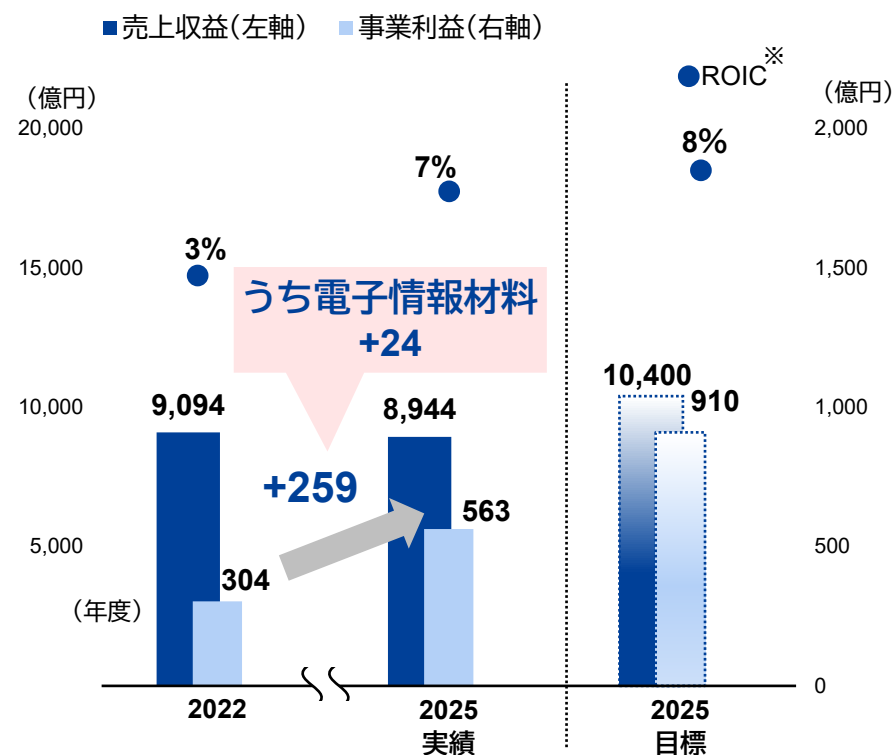


II

AP-G 2025 振り返り

電子情報材料事業としては、**目標未達**となったが、**2022年度比では増益**

業績推移（機能化成品セグメント）



※ ROIC: 税引後事業利益 ÷ 投下資本 (期首・期末平均、事業資産ベース)

電子情報材料事業

2025年度目標: 未達

- **ディスプレイ**
テレビ・PC需要の下振れ、マイクロLED市場の立ち上がり遅れに伴う
拡販目標の未達、有機EL関連材料の未達
- **半導体・電子部品**
xEVなど最終製品需要の伸び悩みに伴う拡販目標の未達

2022年度比、増益

- **半導体・電子部品**
パワー半導体やSAWフィルタ用途でのシェア拡大
パワーインダクタ向け新製品の量産開始
- **印刷**
製缶印刷市場向けの拡大
欧州製造拠点への統合による抜本的なコスト構造改革

Ⅲ

事業環境・需要動向

半導体・ 電子部品

生成AIの需要拡大に伴う データセンター用途の半導体・電子部品の爆発的成長

- 生成AI向けデータセンター投資の拡大
⇒ 高性能ロジック、メモリ、電子部品(インダクタ他)需要の同時拡大
- 高速化、低消費電力に向けて電気から光への転換＝光電融合分野の開発加速
- xEV・再生エネルギーインフラ拡大によるパワー半導体市場の成長

ディスプレイ

ディスプレイの高機能化の更なる進展

- 有機ELディスプレイ比率の上昇と高機能化
- 新デバイス(フォルダブル型スマートフォン、ウェアラブルデバイスなど)向け新規材料開発ニーズ増

印刷

紙媒体の縮小とラベル、軟包装などの包装印刷市場の拡大

- 飲料缶、軟包装、チューブ印刷の需要拡大
- 環境規制の強化を背景に、包装材料のリサイクル化、モノマテリアル化、印刷工程の脱溶剤化(VOCフリー、CO2削減)ニーズ増

IV

中期經營課題 “IGNITION 2028”

コア事業拡大による収益成長を軸に、次世代事業創出を進め、中長期の成長と安定化を実現

事業環境認識

半導体・電子部品

- 生成AIの需要増に伴うデータセンター用途向け急拡大
- 新規技術(光電融合など)の出現



ディスプレイ

- モバイルデバイスの高機能化とフラットパネルディスプレイの進化
- 新デバイス向け材料開発ニーズ



印刷

- 軟包装、チューブ印刷市場拡大
- 飲料缶印刷の高精細化
- 環境要求の高まり



コア事業拡大

成長市場・地域における戦略製品の販売拡大

- ■ ポリイミド材料 ■ ■ シロキサン材料 ■ ■ ペースト材料
- ■ 発光材料 ■ ■ カラーレジスト材料 ■ ■ セラミック材料
- ■ プラスチック光ファイバ ■ ■ COF ■ ■ インダクタコイル
- ■ 樹脂凸版 ■ ■ フレキシ版 ■ ■ オフセット印刷版

次世代事業創出

AIデータセンター分野での新規事業創出

光電融合

先端パッケージ

市場環境の変化を先取りした新製品の開発・投入を通じて、競争優位性を強化し、持続的なシェア拡大を実現
データセンター需要拡大等を見据え、**半導体・電子部品分野への重点投資により新規事業創出を加速**

次の3年間で達成すべき事項

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| ① | 急拡大する半導体・電子部品需要への対応 | <ul style="list-style-type: none">■ 高解像度・環境対応差別化製品の拡販■ 新製品投入によるシェア拡大 |
| ② | ディスプレイ構造変化、新規デバイスによる材料ニーズ変化への対応 | <ul style="list-style-type: none">■ 各社ニーズに対応した製品開発■ 偏向板レスパネル向けポジ型黒色材料等の新製品の拡販に注力 |
| ③ | 飲料缶・チューブ・包装印刷市場への対応 | <ul style="list-style-type: none">■ 飲料缶・チューブ向けには、高精細化ニーズへの対応■ 環境対応軟包装材用印刷版の拡販 |
| ④ | AIデータセンター、光電融合市場に向けた大型新規事業立ち上げ | <ul style="list-style-type: none">■ AIサーバー向けの光電融合材料の開発加速■ 次世代半導体材料の開発、事業化に注力 |
| ⑤ | グローバル連携強化 | <ul style="list-style-type: none">■ 日本、米国、韓国、中国、台湾、シンガポール、ドイツ、チェコのグローバル連携強化 |

IV-1

“IGNITION 2028”
～半導体・電子部品分野～

事業環境認識

パワー半導体

- xEVやデータセンターの成長に伴い拡大基調
- SiC/GaNの本格普及

AI半導体

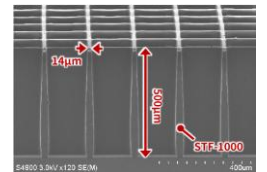
- 生成AIの普及によりAI半導体需要は中長期で拡大
- 高性能化に伴い、微細配線など材料への要求水準高まる

電子部品

- スマホなど携帯端末内部の省スペース化に合わせ、SAWフィルターの軽薄短小のウェハレベルパッケージ比率が増加
- 薄膜型パワーインダクタは電子部品の小型化・高周波対応ニーズを背景に拡大

東レの強み

- 環境対応製品ラインナップ
NMPフリー、フッ素フリー
- 超厚膜・精密めっき技術の展開
- 業界リーダーとの強固な関係



事業戦略

- 環境対応製品による差別化を武器にさらなるシェアアップ
- 超厚膜めっき技術の薄膜型インダクタコイル用途展開による事業拡大
- 生成AI用メモリ・ロジック半導体向け先端パッケージ材料の早期開発・実装

STEMCO 東レとサムスングループの合併会社として1995年韓国に設立

コア技術

1-Metal COF (Chip on Film)

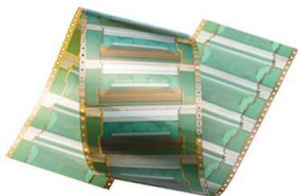
- 精密エッチング



銅エッチング
パターン加工

2-Metal COF (Chip on Film)

- 精密めっき



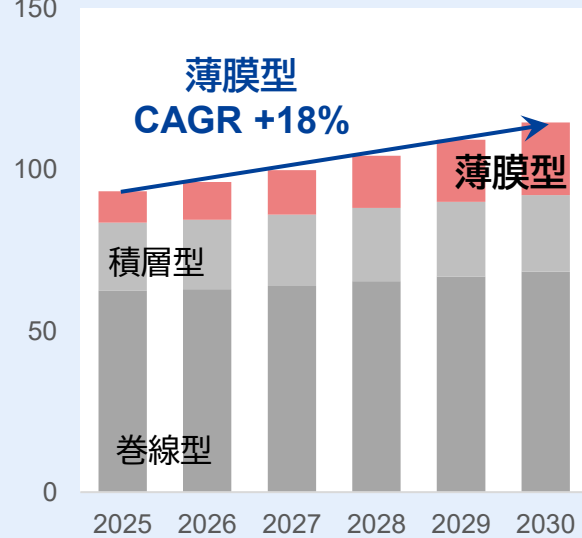
銅パターン
めっき

コア技術の
新規用途
展開

COF量産技術で培った
めっき／高精細技術を活かし
成長市場の薄膜型インダクタコイル市場に展開

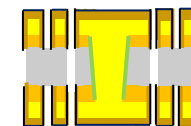
パワーインダクタ市場

(億個/月)



(当社推定)

STEMCO 薄膜型インダクタコイル



- 基板のVia形成
- パターン銅めっき
- エッチング
- CVD

IV-2

“IGNITION 2028”
～ディスプレイ分野～

事業環境認識

有機EL

- スマホ需要が買い替え周期長期化などを背景に年率2%の成長にとどまる中、有機ELディスプレイ採用機種は年率4%拡大見通し
- フォルダブルスマホの拡大、タブレット・PCや車載への用途拡大に伴う、新たな材料への要求

液晶

- ハイエンドモニター用途で広色域化、ブルーライトカット、環境規制対応としてカドミウム(Cd)フリー化などが進む見通し

マイクロLED

- 高輝度・高コントラスト・長寿命などの特性から2030年頃には小型ディスプレイ中心に本格拡大の見通し

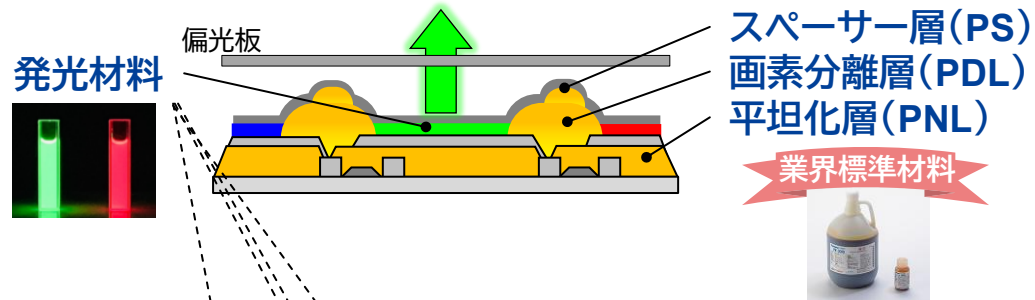
東レの強み

- ポリイミド、シロキサン材料設計開発、量産技術
- Cd/鉛フリー波長変換材料設計開発、量産技術
- サプライチェーンマネジメント

事業戦略

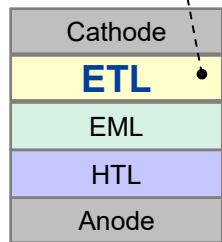
- 将来ニーズをいち早く把握した新製品開発と着実な量産化、優れた品質による差別化
- ニーズを捉えた高機能製品の積極的な販売
 - 偏光板レス 黒色材料
 - Cdフリー 有機波長変換材料

有機ELディスプレイ構造



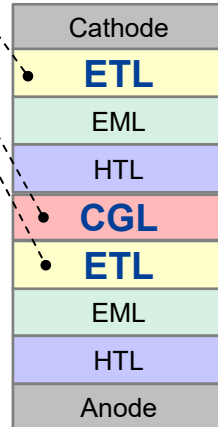
素子構造

シングル構造



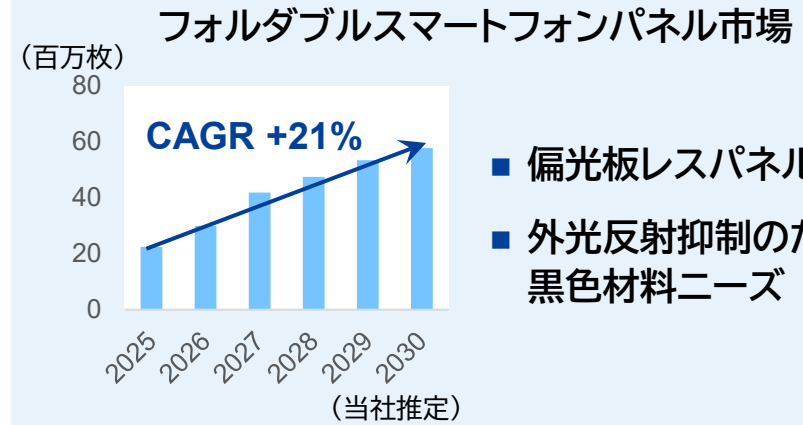
- ✓ スマートフォン
- ✓ スマートウォッチ

タンデム構造



- ✓ テレビ
- ✓ タブレット
- ✓ ノートPC
- ✓ 車載ディスプレイ
- ✓ AR/VRグラス

有機ELディスプレイ向け黑色材料

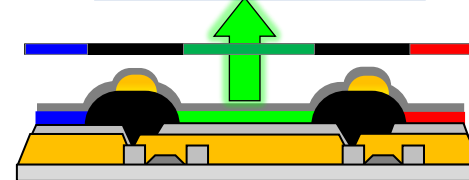


- 偏光板レスパネルを採用
- 外光反射抑制のための黑色材料ニーズ

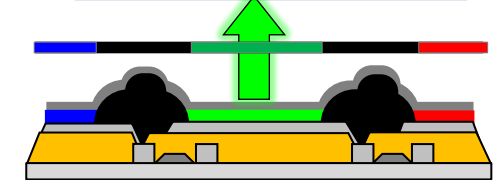
偏光板レスパネル向け黑色材料

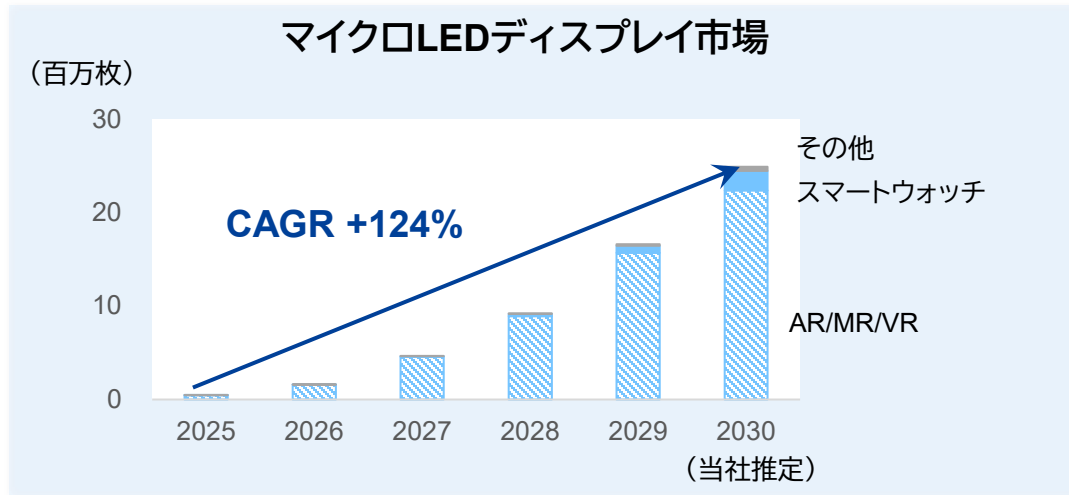
- パネル構造、プロセスに合わせた材料提案

Black PDL(ネガ型)



Black PDL/PS(ポジ型)



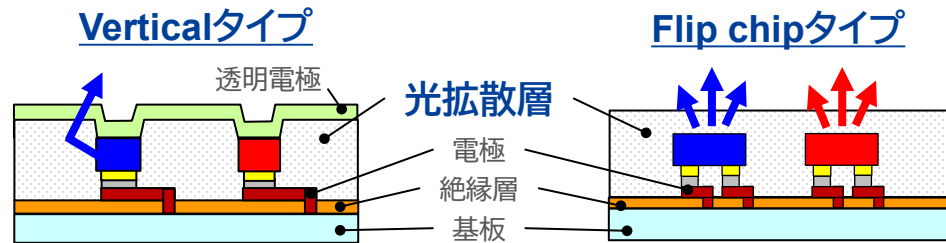


マイクロLEDディスプレイの高輝度化、高コントラスト化に向けて、東レオリジナルの

- 屈折率コントロール技術
- 光拡散技術

を活かし光拡散材料、隔壁材料を開発

光拡散材料

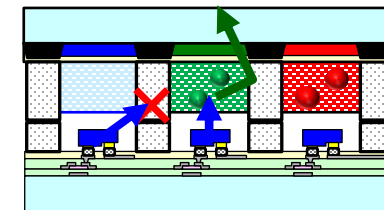


- 高反射、高拡散
- 高解像度、
微細コンタクトホール加工

- 高反射、高拡散
- 優れた平坦化性
- 優れたアンダーフィル性

隔壁材料

Color conversionタイプ



- 顧客ニーズに合わせた遮光性と光反射性のコントロール
- シロキサン材料

IV-3

“IGNITION 2028”
～印刷分野～

事業環境認識

- 商業印刷、出版印刷市場は横ばい～縮小傾向
- 飲料缶・チューブ印刷は着実に拡大、多様化・高精細化
- ECの増加等の運搬包装の変化、人口増加、新興国での消費拡大に伴い、軟包装印刷市場は需要拡大

飲料缶・チューブ

- リサイクル率の高さからアルミ缶が拡大
- 美粧化ニーズの高まりに合わせ、高精細化が進む見通し

軟包装

- 環境規制強化を背景に、包装材料のモノマテリアル化や印刷工程の脱溶剤化の要請が強まる見込み

東シの強み

- 独自の印刷版技術
高精細・高耐久の樹脂凸版・独自のオフセット版
- 環境対応印刷技術
- グローバルネットワーク

事業戦略

- 飲料缶・チューブ: 高精細を訴求、缶・チューブ専用印刷機と組み合わせて、アジア、欧州、中国で拡販
- 軟包装: モノマテリアル化、脱溶剤化のニーズを捉え、高精細化が求められる日本・アジアで拡販

印刷プロセスにおける環境負荷低減と軟包装材のリサイクル性向上により環境へ貢献

<p>2017 軟包装用水なし オフセット印刷 システム開発開始</p>	<p>2020 100%VOCフリー 水なしEBオフセット 印刷技術実証成功</p>	<p>2022 Chemosvit社(スロバキア)と 水なしEBオフセット印刷 共同取り組み開始</p>	<p>2023 100%VOCフリー水なしEBオフセット 印刷使用食品包装材実用化 (ITP Foods Sdn. Bhd.(マレーシア))</p>
<p>2019 軟包装用水なし オフセット印刷機開発</p>	<p>2021 軟包装用水なし オフセット印刷 専用版材製品化</p>	<p>2023 モノマテリアルフィルム 包装材・技術共同開発 (三井化学株式会社、株式会社熊谷)</p>	<p>2024 欧州食品プラスチック規制対応 フィルム包装材・フレキシ印刷技術共同開発 (Dow Inc.、COMEXI GROUP INDUSTRIES, S.A.U.、 サカタインクス株式会社、 SGK JAPAN/株式会社シャーク・ジャパン等)</p>

軟包装印刷市場

(10億US\$)

CAGR +4%

Year	Market Size (10 billion US\$)
2025	~300
2026	~320
2027	~340
2028	~360

(当社推定)

EB水なしオフセット印刷版 EBフレキシ版 ※EB: 電子線

- EB硬化(燃焼処理不要)
- 無溶剤インキ
- 低版コスト

① 低 CO₂排出量
② 多品種小ロット対応
③ 低 VOC排出
④ 低 食品への化学品溶出

モノマテリアル化の取り組み

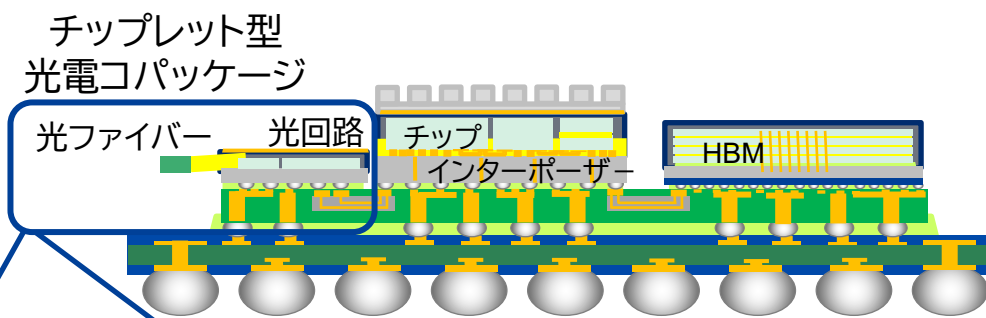
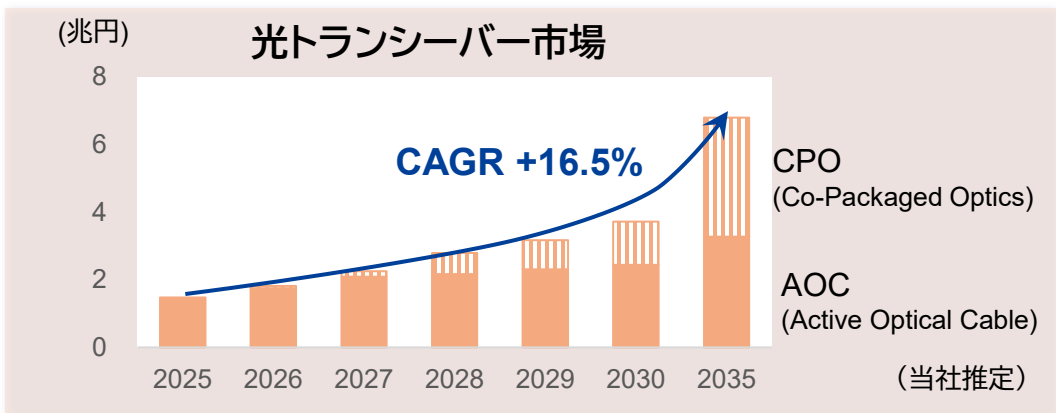
EB印刷版 × EB印刷技術 × モノマテフィルム蒸着技術 → モノマテリアル軟包装材用 新規材料・製造プロセス設計

従来パッケージ	モノマテリアルパッケージ
<ul style="list-style-type: none"> 易接着PET EBインキ アルミ箔 CPP <p>異種積層 リサイクル困難</p>	<ul style="list-style-type: none"> EBニス EBインキ 複層PE <p>モノマテリアル + 接着剤フリー 易リサイクル性</p>

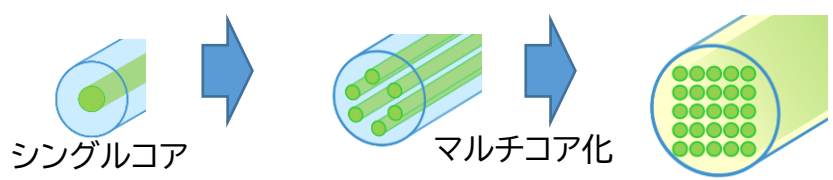
IV-4

“IGNITION 2028”
～成長分野～

次世代高速通信における低消費電力化に向けて、光電融合向け材料・技術の開発推進



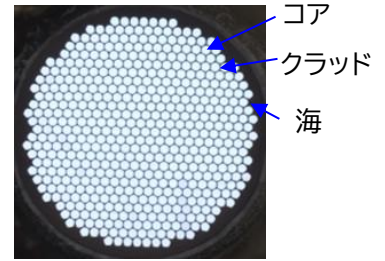
通信用マルチコアプラスチック光ファイバ



マルチコア化による通信の大容量化

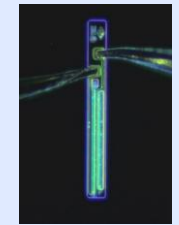
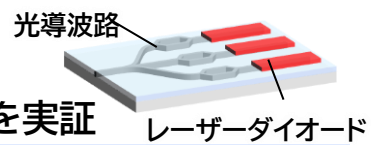
要素技術: NANODESIGN®

超精密な複合紡糸口金断面
微細な流れで断面を形成



光電融合向け実装技術

レーザーダイオードの
マストランスファー実装技術を実証

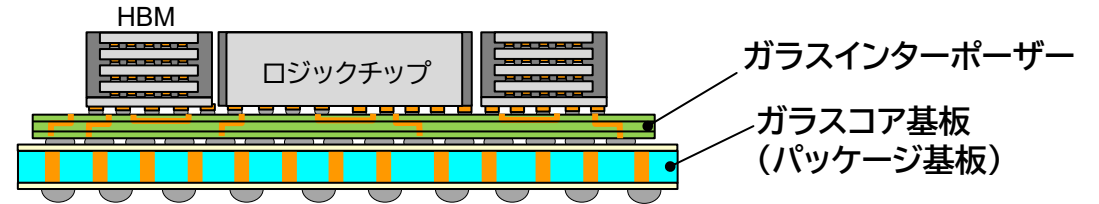


電気特性評価の様子

技術トレンド

チップ、HBM搭載数増により大型化・高密度化

- インターポージャー大型化⇒パネルプロセス化
- 接続Pin数の増大⇒配線微細化
- 基板反り増大⇒反りに有利なガラスコア基板



ガラスコア基板用材料

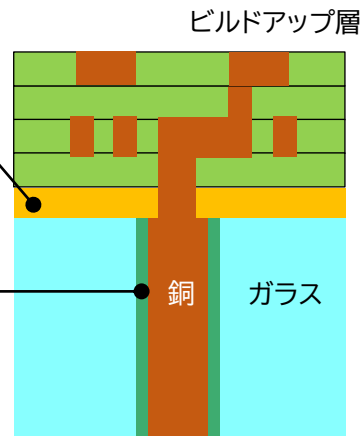
～新たな基板や構造に対応する材料技術～

①ストレスバッファー用材料

- 弾性率制御
- ビルドアップ層とガラス間の応力を緩和

②ガラス強化材料

- ガラス貫通孔や基板端部の割れ防止



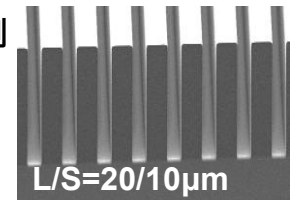
インターポージャー用材料、再配線用絶縁膜

～微細化、基板大型化に対応する材料技術～

①感光性ポリイミドシート

- 大型パネルプロセスに対応したドライフィルムタイプ絶縁膜
- 低収縮で反り低減に寄与

加工例



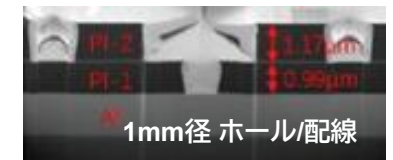
②先端パッケージ向け

次世代感光性ポリイミドコーティング剤 (開発中)

③非感光

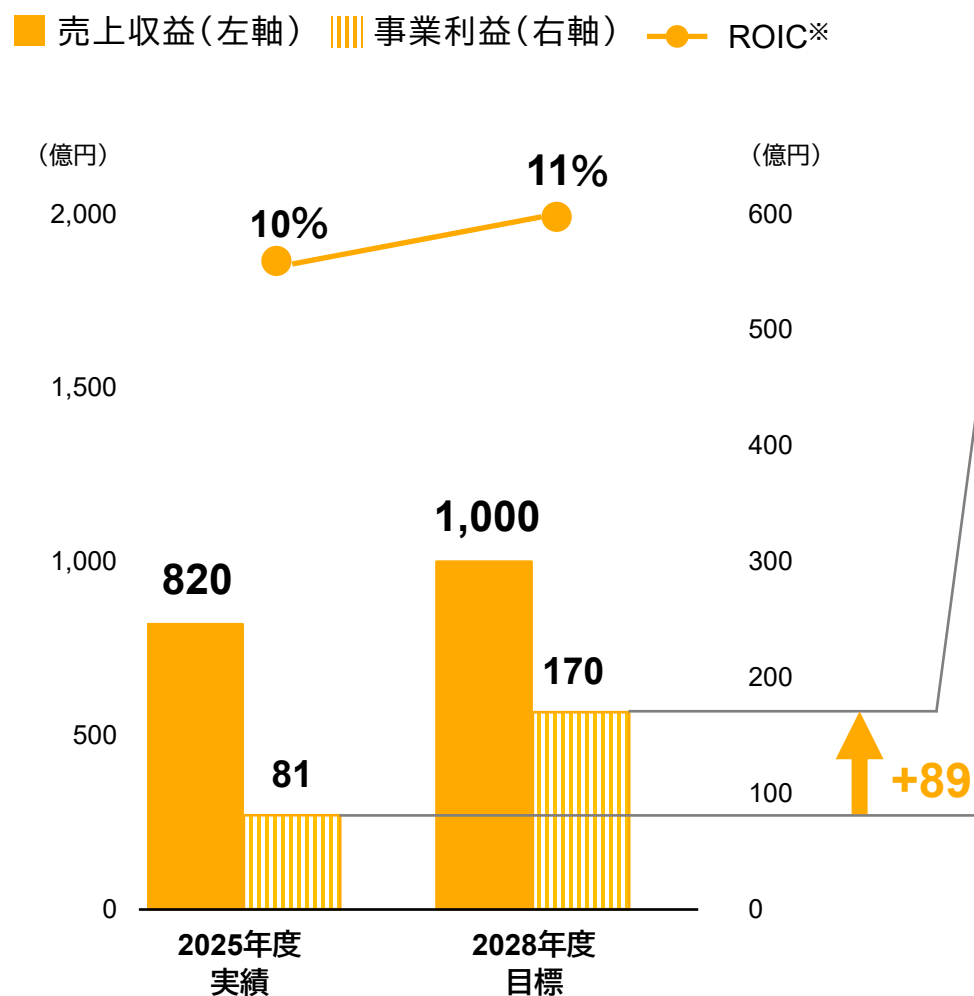
ポリイミドコーティング剤

- 微細加工と良好な膜物性を両立



V

2028年度の目標値と 個別事業・施策の寄与度



※ ROIC: 税引後事業利益 ÷ 投下資本 (期首・期末平均、事業資産ベース)

成長戦略

半導体・電子部品

■ 環境対応製品の拡販

パワー半導体メーカー向けにNMPフリー品などの環境規制に適合したポリイミドコーティング剤新製品を拡販

■ STEMCOの新製品拡販

合弁パートナーで、薄膜型パワーインダクタのトップシェアを有する三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) と協業し、「勝ちパターン」戦略を強化

ディスプレイ

■ 有機EL関連材料の新製品拡販

ハーフトーン加工が可能で耐薬品性に優れるポジ型黒色材料などの独自製品を市場投入し、「勝ちパターン」戦略を刷新

印刷

■ 飲料缶・チューブ市場での拡販、環境対応軟包装印刷立ち上げ

2029年以降のさらなる飛躍に向けた新事業の立ち上げ

■ マルチコア光ファイバの事業化

独自のNANODESIGN®技術と樹脂流動制御技術により、データセンターなどで需要が高まる大容量通信や通信用レーザーモジュールの低コスト化に寄与する光ファイバを上市

本資料中の業績見通し及び事業計画についての記述は、現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています。

本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。

